

附錄五

法定及一般資料

A. 有關本公司及我們子公司的進一步資料

1. 成立

本公司於2019年8月26日在中國註冊成立為有限責任公司，並於2026年5月18日根據中國法律改制為股份有限公司。於最後實際可行日期，本公司的註冊股本為人民幣846,544,528元。

本公司已在香港香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓設立營業地點。本公司已於[●]根據公司條例第16部在香港公司註冊處註冊為非香港公司。林慧怡女士已獲委任為本公司的授權代表，代表本公司於香港接收送達法律程序文件及通知。送達法律程序文件的地址與上文所載本公司香港主要營業地點相同。

由於我們在中國成立，我們的公司架構及公司章程受中國相關法律法規規限。我們的公司章程的相關條文概要載於「附錄四—公司章程概要」。

2. 本公司股本變動

於2025年7月30日，本公司的註冊股本由178,464,543美元減少至110,131,210美元。

於2026年5月18日本公司完成股份制改組後，本公司的註冊資本由110,131,210美元變更為人民幣737,655,639元。於我們改制為股份有限公司當日，我們的註冊資本為人民幣737,655,639元，分為737,655,639股已發行股份，每股面值人民幣1.00元，該等股份已由我們的發起人繳足。

本公司的註冊資本由人民幣737,655,639元增加至人民幣846,544,528元，分為846,544,528股已發行股份，於2026年5月18日生效。

除上文所披露者外，緊接本文件日期前兩年內，本公司的股本並無任何變動。

3. 我們子公司的股本變動

我們子公司的公司資料及詳情概要載於本文件附錄一會計師報告附註24。

附錄五

法定及一般資料

除下文及本文件附錄一所載會計師報告所披露者外，緊接本文件日期前兩年內，我們任何子公司的股本並無任何變動。

子公司名稱	變更日期	變更前股本	變更後股本
禮鼎秦皇島	2026年6月8日	人民幣 500,000,000 元	人民幣 850,000,000 元

4. 我們股東的決議案

於2026年6月25日舉行的股東大會上，我們的股東議決(其中包括)批准以下各項：

- (a) 本公司[編纂]每股面值人民幣1.00元的H股，且該等H股在聯交所[編纂]；
- (b) [編纂]獲行使前將予[編纂]的H股數目不得超過經[編纂]擴大後本公司已發行股本總額的[編纂]，並授予[編纂]不超過根據[編纂][編纂]的H股數目[編纂]的[編纂]；
- (c) 授權董事會或其授權人士處理(其中包括)與[編纂]、[編纂]及[編纂]H股有關的事宜；及
- (d) 待[編纂]完成後，有條件採納公司章程，該章程將於[編纂]生效，並授權董事會根據相關法律法規及應聯交所及相關中國監管機構的要求修訂公司章程。

B. 有關我們業務的進一步資料

1. 重大合同概要

我們於緊接本文件日期前兩年內訂立了以下合同(並非於日常業務過程中訂立的合同)，屬或可能屬重大：

- (a) [編纂]。

附錄五

法定及一般資料

2. 知識產權

(a) 商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務屬或可能屬重大的商標：

編號	商標	註冊地點	註冊擁有人	類別	註冊編號	註冊日期
1.		中國	本公司	40	52150888	2021-08-28
2.		中國	本公司	9	52145776	2021-08-28
3.		中國台灣	本公司	9	2168403	2021-09-16
4.		中國台灣	本公司	40	2170482	2021-09-16
5.		美國	本公司	9	6748122	2022-05-31
6.		中國台灣	本公司	9	2168402	2021-09-16
7.		中國台灣	本公司	40	2170481	2021-09-16
8.		美國	本公司	9	6840344	2022-09-06
9.		中國台灣	本公司	9	2510463	2026-02-01
10.		中國台灣	本公司	9	2510462	2026-02-01
11.		中國台灣	本公司	9	2510448	2026-02-01

附錄五

法定及一般資料

截至最後實際可行日期，我們已申請註冊以下我們認為對業務屬或可能屬重大的商標：

編號	商標	申請地點	申請人	類別	申請編號	申請日期
1.		中國	本公司	9	88770580	2025-11-24
2.		中國台灣	本公司	9	114086381	2025-11-24
3.		香港	本公司	9	307197841	2026-02-24
4.		香港	本公司	9	307199641	2026-02-26
5.		香港	本公司	9	307199650	2026-02-26
6.		香港	本公司	9	307199669	2026-02-26
7.		香港	本公司	9	307199678	2026-02-26

(b) 著作版權

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務屬或可能屬重大的軟件著作版權：

編號	版權	註冊地點	註冊編號	註冊日期
1.	軟金線線體參數防呆軟件.....	中國	2025SR2530477	2025-12-30
2.	EMP系統.....	中國	2023SR1495310	2023-11-23
3.	EAP特別版軟件.....	中國	2024SR0817917	2024-06-17

附錄五

法定及一般資料

(c) 專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務屬或可能屬重大的專利：

編號	專利名稱	類型	專利權人	註冊地點	專利號	授予日期
1.	封裝基板及封裝結構	實用新型	本公司及禮鼎半導體科技秦皇島有限公司	中國	ZL202120620741.5	2021-11-23
2.	槽體、迴圈裝置及循環系統	實用新型	本公司及禮鼎半導體科技秦皇島有限公司	中國	ZL202221579308.2	2022-11-15
3.	加熱板組件	實用新型	本公司及禮鼎半導體科技秦皇島有限公司	中國	ZL202221527157.6	2022-12-09
4.	封裝結構	實用新型	本公司及禮鼎半導體科技秦皇島有限公司	中國	ZL202221416390.7	2022-12-13
5.	焊料印刷結構	實用新型	本公司及禮鼎半導體科技秦皇島有限公司	中國	ZL202221331155.X	2022-12-13
6.	壓合元件及壓合裝置	實用新型	本公司及禮鼎半導體科技秦皇島有限公司	中國	ZL202221526175.2	2022-12-13
7.	電路板元件	實用新型	本公司及禮鼎半導體科技秦皇島有限公司	中國	ZL202221650311.9	2022-12-13
8.	再生系統	實用新型	本公司及禮鼎半導體科技秦皇島有限公司	中國	ZL202221893658.6	2022-12-20
9.	電路板以及電子裝置	實用新型	本公司及禮鼎半導體科技秦皇島有限公司	中國	ZL202222151385.4	2023-02-21
10.	球柵陣列植球機	實用新型	本公司及禮鼎半導體科技秦皇島有限公司	中國	ZL202222503454.3	2023-03-17
11.	印刷電路板壓合裝置	實用新型	本公司及禮鼎半導體科技秦皇島有限公司	中國	ZL202222562310.5	2023-03-17
12.	封裝基板	實用新型	本公司及禮鼎半導體科技秦皇島有限公司	中國	ZL202222529916.9	2023-04-14

附錄五

法定及一般資料

編號	專利名稱	類型	專利權人	註冊地點	專利號	授予日期
13.	便於排液的掛籃	實用新型	本公司及禮鼎半導體科技秦皇島有限公司	中國	ZL202321230222.3	2023-10-10
14.	吸盤、吸附機構及曝光設備	實用新型	本公司及禮鼎半導體科技秦皇島有限公司	中國	ZL202320968934.9	2023-11-10
15.	遮板	實用新型	本公司及禮鼎半導體科技秦皇島有限公司	中國	ZL202321693142.1	2023-12-08
16.	傳送裝置	實用新型	本公司及禮鼎半導體科技秦皇島有限公司	中國	ZL202322006402.X	2024-02-02
17.	具有內埋元件的電路板及其製作方法	發明專利	禮鼎半導體科技秦皇島有限公司及臻鼎科技股份有限公司	中國	ZL201310204368.5	2017-08-11
18.	封裝基板及其製作方法 . . .	發明專利	禮鼎半導體科技秦皇島有限公司及臻鼎科技股份有限公司	中國	ZL201210561911.2	2017-10-27
19.	晶片封裝結構、具有內埋元件的電路板及其製作方法	發明專利	禮鼎半導體科技秦皇島有限公司及臻鼎科技股份有限公司	中國	ZL201210577545.X	2017-01-11
20.	電路板及其製作方法	發明專利	禮鼎半導體科技秦皇島有限公司及臻鼎科技股份有限公司	中國	ZL201310270638.2	2017-10-27
21.	具有內埋元件的電路板及其製作方法	發明專利	禮鼎半導體科技秦皇島有限公司及臻鼎科技股份有限公司	中國	ZL201210561907.6	2017-05-31
22.	IC載板、具有該IC載板的半導體器件及製作方法 .	發明專利	禮鼎半導體科技秦皇島有限公司及臻鼎科技股份有限公司	中國	ZL201310357713.9	2017-06-23
23.	電路板及其製作方法	發明專利	禮鼎半導體科技秦皇島有限公司及臻鼎科技股份有限公司	中國	ZL201210363035.2	2017-03-01

附 錄 五

法 定 及 一 般 資 料

編號	專利名稱	類型	專利權人	註冊地點	專利號	授予日期
24.	無芯層封裝結構及其製造方法	發明專利	禮鼎半導體科技秦皇島有限公司及臻鼎科技股份有限公司	中國	ZL201310294203.1	2017-05-24
25.	連接基板及層迭封裝結構	發明專利	禮鼎半導體科技秦皇島有限公司及臻鼎科技股份有限公司	中國	ZL201210415956.9	2016-12-21
26.	電路板及其製作方法	發明專利	禮鼎半導體科技秦皇島有限公司及臻鼎科技股份有限公司	中國	ZL201210502222.4	2017-03-01
27.	無芯層封裝基板及其製作方法	發明專利	禮鼎半導體科技秦皇島有限公司及臻鼎科技股份有限公司	中國	ZL201310265770.4	2017-08-25
28.	連接基板及層迭封裝結構	發明專利	禮鼎半導體科技秦皇島有限公司及臻鼎科技股份有限公司	中國	ZL201210379202.2	2016-08-24
29.	晶片封裝基板和結構及其製作方法	發明專利	禮鼎半導體科技秦皇島有限公司及臻鼎科技股份有限公司	中國	ZL201210360263.4	2016-11-09
30.	電路板及其製作方法	發明專利	禮鼎半導體科技秦皇島有限公司及臻鼎科技股份有限公司	中國	ZL201410569679.6	2019-01-25
31.	散熱片及其製作方法及電子設備	發明專利	禮鼎半導體科技秦皇島有限公司及臻鼎科技股份有限公司	中國	ZL201510351996.5	2019-04-16
32.	封裝結構及其製作方法	發明專利	禮鼎半導體科技秦皇島有限公司及臻鼎科技股份有限公司	中國	ZL201610255094.6	2020-05-19
33.	封裝基板及其製作方法	發明專利	禮鼎半導體科技秦皇島有限公司	中國	ZL201811240361.8	2021-10-19
34.	電路板、電路板元件以及電子裝置	實用新型	禮鼎半導體科技秦皇島有限公司及本公司	中國	ZL202120599782.0	2021-11-23

附錄五

法定及一般資料

編號	專利名稱	類型	專利權人	註冊地點	專利號	授予日期
35.	IC載板的製備裝置及 IC載板	實用新型	禮鼎半導體科技秦皇島 有限公司及本公司	中國	ZL202120812983.4	2022-04-01
36.	掛具	實用新型	禮鼎半導體科技秦皇島 有限公司及本公司	中國	ZL202220671857.6	2022-09-16
37.	超聲波清潔裝置	實用新型	禮鼎半導體科技秦皇島 有限公司及本公司	中國	ZL202220666658.6	2022-09-16
38.	電路板	實用新型	禮鼎半導體科技秦皇島 有限公司及本公司	中國	ZL202220633788.X	2022-11-29
39.	膜壓裝置	實用新型	禮鼎半導體科技秦皇島 有限公司及本公司	中國	ZL202220574473.2	2022-11-29
40.	電路板製作用固定治具 . . .	實用新型	禮鼎半導體科技秦皇島 有限公司及本公司	中國	ZL202220672152.6	2023-04-07
41.	電路板及其製作方法	發明專利	禮鼎半導體科技秦皇島 有限公司及本公司	中國	ZL201811361685.7	2023-04-18
42.	回流焊測溫載具及回流焊 測溫裝置	實用新型	禮鼎半導體科技秦皇島 有限公司及本公司	中國	ZL202223457976.0	2023-06-09
43.	檢測結構	實用新型	禮鼎半導體科技秦皇島 有限公司及本公司	中國	ZL202223460082.7	2023-06-20
44.	傳輸元件及傳輸結構	實用新型	禮鼎半導體科技秦皇島 有限公司及本公司	中國	ZL202320627247.0	2023-08-18
45.	線路板的製備方法	發明專利	禮鼎半導體科技秦皇島 有限公司及本公司	中國	ZL202011338132.7	2024-03-22
46.	送料機構及收料設備	實用新型	禮鼎半導體科技秦皇島 有限公司及本公司	中國	ZL202321853965.6	2024-03-29
47.	封裝結構	實用新型	本公司及禮鼎半導體科 技秦皇島有限公司	中國	ZL202322597067.5	2024-05-10

附 錄 五

法 定 及 一 般 資 料

編號	專利名稱	類型	專利權人	註冊地點	專利號	授予日期
48.	撕膜機	實用新型	本公司及禮鼎半導體科技秦皇島有限公司	中國	ZL202322609524.8	2024-07-02
49.	芯粒封裝結構	實用新型	本公司及禮鼎半導體科技秦皇島有限公司	中國	ZL202321961053.0	2024-08-30
50.	擋水輪組及蝕刻裝置	發明專利	本公司及禮鼎半導體科技秦皇島有限公司	中國	ZL202110817946.7	2024-12-27
51.	電路板元件和電子產品 . . .	實用新型	禮鼎半導體科技秦皇島有限公司及本公司	中國	ZL202420783552.3	2025-01-17
52.	半導體封裝體的測試裝置 .	實用新型	本公司及禮鼎半導體科技秦皇島有限公司	中國	ZL202420077044.3	2025-03-07
53.	線路板的製作方法	發明專利	本公司及禮鼎半導體科技秦皇島有限公司	中國	ZL202110837772.0	2025-05-27
54.	封裝電路結構及其製作方法	發明專利	禮鼎半導體科技秦皇島有限公司及本公司	中國	ZL202110097582.X	2025-05-27
55.	具有微間距導電凸塊的基板及其製造方法	發明專利	本公司及禮鼎半導體科技秦皇島有限公司	中國	ZL202311830765.3	2025-05-27
56.	封裝結構及其製造方法 . . .	發明專利	本公司	中國	ZL202111512130.X	2024-10-22
57.	滾輪清潔結構、清潔裝置及清潔方法	發明專利	本公司	中國	ZL202111552707.X	2025-10-28
58.	細線路電路板的製作方法 .	發明專利	本公司及禮鼎半導體科技秦皇島有限公司	中國	ZL202111217605.2	2025-11-25
59.	封裝基板的噴淋裝置	實用新型	本公司及禮鼎半導體科技秦皇島有限公司	中國	ZL202422314074.4	2025-09-19
60.	光罩及曝光設備	實用新型	本公司及禮鼎半導體科技秦皇島有限公司	中國	ZL202520580521.2	2026-03-26

附錄五

法定及一般資料

編號	專利名稱	類型	專利權人	註冊地點	專利號	授予日期
61.	封裝電路結構的製造方法	發明專利	禮鼎半導體科技秦皇島有限公司及本公司	美國	US17/218556	2021-03-31
62.	封裝基板、封裝結構及其製作方法	發明專利	禮鼎半導體科技秦皇島有限公司	中國台灣	TW106116320	2017-05-17
63.	線路板的製備方法	發明專利	禮鼎半導體科技秦皇島有限公司及本公司	中國台灣	TW109142126	2020-11-30
64.	封裝電路結構及其製作方法	發明專利	禮鼎半導體科技秦皇島有限公司及本公司	中國台灣	TW110103733	2021-02-01
65.	封裝基板、其製造方法及具有該封裝基板的晶片封裝結構	發明專利	禮鼎半導體科技秦皇島有限公司及臻鼎科技股份有限公司	美國	US14/097251	2013-12-05
66.	線路板及其製造方法	發明專利	禮鼎半導體科技秦皇島有限公司及本公司	中國台灣	TW112141409	2023-10-27
67.	晶片封裝結構及其製作方法和電子設備	發明專利	禮鼎半導體科技秦皇島有限公司	中國台灣	TW112115405	2023-04-25
68.	封裝電路結構	發明專利	禮鼎半導體科技秦皇島有限公司及本公司	美國	US18/123881	2023-03-20

截至最後實際可行日期，我們的知識產權組合包括於中國內地及美國共17項重大共同擁有專利。有關我們就該等重大共同擁有專利所享有權利的分析，請參閱「與控股股東的關係—不競爭承諾，以及—獨立於控股股東—研發」。

附錄五

法定及一般資料

3. 域名

截至最後實際可行日期，我們擁有以下我們認為對業務屬或可能屬重大的域名：

編號	域名	註冊擁有人	註冊日期
1.	leadingics.com	本公司	2022-11-21
2.	eleadingics.com	本公司	2022-11-21
3.	leadingics.com.cn	本公司	2022-11-21

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，並無其他對我們業務而言屬重大的商標或服務標誌、專利、知識或工業產權。

C. 有關我們董事及主要股東的進一步資料

1. 董事及公司行政總裁的權益披露

緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，就董事所知，概無董事或行政總裁於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例有關條文被當作或被視為擁有的權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須記錄於該條例所指登記冊的權益或淡倉，或根據上市規則所載[編纂]發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

2. 主要股東的權益披露

(a) 於本公司的權益

有關緊隨[編纂]完成後在本公司股份或相關股份中擁有或被視為或被當作擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須知會本公司及聯交所的權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可在所有情況下於本公司股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益的人士資料，請參閱「主要股東」一節。

(b) 我們集團其他成員公司的主要股東權益

於最後實際可行日期，我們的子公司均由我們全資擁有，且董事並不知悉任何人士將於緊隨[編纂]完成後直接或間接擁有我們集團其他成員公司(本公司除外)已發行具有投票權股份的10%或以上權益。

附錄五

法定及一般資料

3. 服務合同

我們已與各董事就(其中包括)遵守相關法律法規、公司章程及適用的仲裁條文訂立合同。

除上文所披露者外，我們並無亦不建議與任何董事以其董事身分訂立任何服務合同(不包括於一年內屆滿或僱主可於一年內免付賠償(法定賠償除外)而終止的合同)。

4. 董事薪酬

除「董事及高級管理層」一節及截至2025年12月31日止三個年度及截至2026年3月31日止三個月「附錄一—會計師報告」附註34所披露者外，概無董事從我們收取其他薪酬或實物福利。

5. 免責聲明

除本文件所披露者外：

(a) 概無董事或下文「— E.其他資料—4.專家資格」所列任何人士：

- (i) 於我們的發起中擁有權益，或於緊接本文件日期前兩年內由我們收購或出售或租賃給我們，或擬由我們收購或出售或租賃給我們的任何資產中擁有權益；
- (ii) 於本文件日期存續且對我們業務而言屬重大的任何合同或安排中擁有重大權益；

(b) 除與[編纂]及[編纂]有關者外，下文「— E.其他資料—4.專家資格」所列任何人士：

- (i) 並無合法或實益擁有我們集團任何成員公司的任何股份權益；或
- (ii) 並無任何權利(無論是否可依法強制執行)可認購或提名他人認購我們集團任何成員公司的任何證券；

(c) 概無董事或其緊密聯繫人或就董事所知擁有我們已發行股本5%以上的本公司股東，在我們的五大客戶或五大供應商中擁有任何權益；及

(d) 一旦H股在聯交所[編纂]，概無董事在根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須予披露的本公司股本中擁有權益的公司擔任董事或員工。

附錄五

法定及一般資料

D. 員工持股計劃

以下為本公司於2026年5月12日採納的與我們員工持股平台相關的員工持股計劃的主要條款概要，該計劃旨在為本集團吸引及挽留人才。根據員工持股計劃，合資格參與者有權獲得員工持股平台的股權（「計劃股份」）。截至最後實際可行日期，員工持股計劃項下的所有計劃股份已授予合資格參與者。有關各員工持股平台的股權架構及計劃股份承授人（包括兩名董事）的詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構—員工持股平台」。截至最後實際可行日期，員工持股平台持有我們已發行股份總數約9.81%。由於員工持股計劃不涉及本公司授出購股權以認購新股或於[編纂]時授出股份獎勵，故員工持股計劃不受上市規則第17章條文規限。

(a) 目的

員工持股計劃的目的是為本集團吸引及挽留人才，並促進股東與員工之間的利益共享，從而使本公司更專注於長期發展。

(b) 合資格參與者

有資格參與員工持股計劃的人士為在本集團擔任重要職務的員工，以及員工持股計劃管理人認為合適的任何其他人士。

(c) 歸屬

已授出的計劃股份將按以下方式歸屬：

- i. 20%於[編纂]一週年與2027年3月31日兩者中的較後日期歸屬；
- ii. 20%於[編纂]一週年與2028年3月31日兩者中的較後日期歸屬；
- iii. 20%於[編纂]一週年與2029年3月31日兩者中的較後日期歸屬；
- iv. 20%於[編纂]一週年與2030年3月31日兩者中的較後日期歸屬；及
- v. 20%於[編纂]一週年與2031年3月31日兩者中的較後日期歸屬。

倘承授人的相應僱傭合同在計劃股份歸屬前終止，該等計劃股份可由普通合夥人或相應員工持股平台指定的其他承授人根據管理人的指示按原授出價格回購，或按管理人的指示繼續持有。

(d) 計劃股份的處置

計劃股份歸屬後，承授人對其計劃股份的任何退出或減持，應通過相應員工持股平台處置其持有的股份來實現。該等處置的所得款項在扣除適用稅項及開支（包括營運開支）後，將分派給相關承授人。

附錄五

法定及一般資料

E. 其他資料

1. 遺產稅

董事獲告知，本公司或我們的子公司不大可能承擔重大遺產稅責任。

2. 訴訟

就董事所知，我們集團任何成員公司概無面臨任何待決或威脅提出的重大訴訟或索償。

3. 獨家保薦人

獨家保薦人已代表我們向[編纂][編纂][編纂]我們已發行的H股、根據[編纂]將予[編纂]的H股(包括因[編纂]獲行使而可能發行的任何H股)[編纂]及買賣。所有必要安排均已作出，以使該等[編纂]獲准納入[編纂]。

根據本公司與獨家保薦人訂立的委聘書，我們已同意就[編纂]建議[編纂]向獨家保薦人支付費用900,000美元作為保薦人費用，截至最後實際可行日期，該費用尚未全額支付予獨家保薦人。

中信証券(香港)有限公司符合上市規則第3A.07條適用於保薦人的獨立性準則。請參閱「[編纂]」。

4. 專家資格

於本文件提供意見或建議的專家資格如下：

名稱	資格
中信証券(香港)有限公司	獲發牌從事證券及期貨條例所界定的第4類(就證券提供意見)及第6類(就企業融資提供意見)受規管活動的法團
羅兵咸永道會計師事務所	《專業會計師條例》(香港法例第50章)下的執業會計師 《會計及財務匯報局條例》(香港法例第588章)下的註冊公眾利益實體核數師
金杜律師事務所	有關中國法律的法律顧問
金杜律師事務所	有關中國知識產權法律的法律顧問
Tsai, Lee & Chen	有關美國知識產權法律的法律顧問
恆業法律事務所	有關中國台灣法律的法律顧問

附錄五

法定及一般資料

名稱	資格
霍金路偉律師事務所	有關國際制裁、美國出口管制、關稅法律及對外投資規則的法律顧問
弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司 . . .	獨立行業顧問
戴德梁行有限公司	獨立物業估值師
畢馬威企業諮詢(中國)有限公司深圳分公司	轉讓定價顧問

上述各專家已各自發出書面同意書，同意按本文件所載形式及涵義轉載其報告、函件及／或法律意見(視情況而定)及引述其名稱，且迄今並無撤回其同意書。

於最後實際可行日期，上述專家概無擁有本公司或我們任何子公司的任何股份權益，或擁有可認購或提名他人認購我們集團任何成員公司證券的權利(無論是否可依法強制執行)。

[編纂]

7. 合規顧問

本公司已委任浩德融資有限公司為合規顧問，以遵守上市規則第3A.19條。

8. 初步開支

本公司並無就上市規則的目的產生重大初步開支。

9. 並無重大不利變動

董事確認，截至本文件日期，自2026年3月31日以來，我們的財務或財務狀況並無重大變動。

附錄五

法定及一般資料

10. 發起人

本公司的發起人包括本公司於改制為股份有限公司當日（即2026年5月18日）的全體當時股東。除本文件所披露者外，緊接本文件日期前兩年內，並無就[編纂]或本文件所述相關交易向上述發起人支付、配發或贈予，或擬支付、配發或贈予任何現金、證券或利益。

11. H股持有人的稅項

香港印花稅目前按H股代價或市值（以較高者為準）的從價稅率0.10%收取，將由買方在每次購買時及賣方在每次出售任何香港證券（包括H股）時支付（換言之，目前[編纂]的典型買賣交易合共須支付0.20%的稅率）。此外，目前任何H股轉讓文書須繳付5.00港元的定額印花稅。倘其中一方為香港境外居民且並未繳付其應付的從價稅，則未繳付的稅款將在轉讓文書（如有）上評定，並由承讓人支付。倘未在到期日或之前繳付印花稅，則可能被處以應繳稅款高達10倍的罰款。

12. 雜項

除本文件所披露者外：

- (a) 於本文件日期前兩年內：(i)我們並無發行或同意發行任何繳足或部分繳足的股份或借貸資本，以換取現金或非現金代價；(ii)並無就發行或出售本公司任何股份授出任何佣金、折扣、經紀費或其他特別條款；及(iii)並無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司任何股份或債權證支付或應付任何佣金；
- (b) 本公司概無任何股份或借貸資本受期權規限，或有條件或無條件同意受期權規限；
- (c) 我們並無發行或同意發行任何創始人股份、管理層股份或遞延股份；
- (d) 並無為期超過一年且對我們業務而言屬重大的廠房及機器租購合同；
- (e) 並無任何放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (f) 並無任何程序可行使任何優先購買權或認購權的可轉讓性；
- (g) 過去12個月，我們的業務並無中斷而可能對我們的財務狀況有或已有重大影響；
- (h) 並無任何限制影響我們將利潤匯入香港或自香港以外匯回資本；

附 錄 五

法 定 及 一 般 資 料

- (i) 本公司任何股權或債務證券（如有）目前並無在任何證券交易所或交易系統[編纂]或[編纂]，且目前或同意並無尋求在[編纂]以外的任何證券交易所[編纂]或獲准[編纂]；
- (j) 本公司並無未償還可換股債務證券或債權證；及
- (k) 本公司為股份有限公司，承擔有限責任，並受中國公司法規限。